



2022年12月5日

各 位

## 「Advanced Packaging and Chiplet Summit (APCS) 2022」展に出展

三井金属は、2022年12月14日（水）～12月16日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて初開催される「Advanced Packaging and Chiplet Summit (APCS) 2022展」に以下の通り出展いたします。

当展示会は「SEMICON Japan 2022展」と併設しており、半導体パッケージング関連の最新技術・ソリューションが一堂に会します。当社からは次世代パワー半導体向け接合材料として、焼結型銅ペーストを出展いたします。EV、発電・送配電機器、産業機器等の用途で高出力・高信頼性が求められるパワーデバイス向けに、高信頼・高耐熱・低環境負荷（鉛フリー）の材料として期待されております。また、独自の材料設計により190 W / (m・K)の熱伝導性、-55℃～150℃、1,000 cycの信頼性を確認しており、窒素環境下で焼結出来る事から既存の銀系プロセスへの適用も可能です。

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが、何とぞご光来賜りたくご案内申し上げます。

### ■出展概要

展示会名称：「Advanced Packaging and Chiplet Summit (APCS) 2022」展

開催期間：2022年12月14日（水）～16日（金）午前10時～午後5時

開催場所：東京ビッグサイト・東ホール

三井金属ブース：APCS:3953

公式サイト：<https://www.semiconjapan.org/jp/apcs>

出展製品：パワー半導体向け焼結型銅ペースト



写真1:焼結型銅ペースト

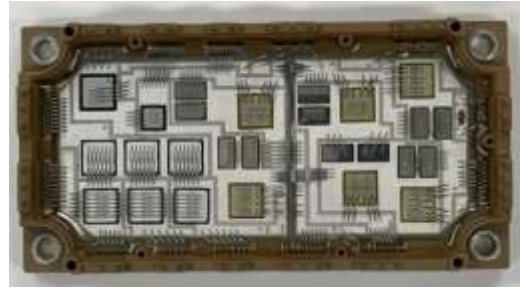


写真2:当社銅ペーストを使用した  
パワーモジュール試作品

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL 03-5437-8028 E-mail [PR@mitsui-kinzoku.com](mailto:PR@mitsui-kinzoku.com)